

株式会社 アルバック

2026 年 6 月期 4Q WEB 決算説明会（2026 年 8 月 14 日開催）

およびアナリストミーティングの主な質疑応答

【26/6 期 決算概要】

1. 26/6 期の通期実績について、増収減益での着地となりましたが、事業環境とともに総括してください。

A: 半導体電子・ディスプレイ・レアアース関連を含む一般産業が牽引し、受注高は前期比 987 億円増となる 3,242 億円と過去最高を更新いたしました。旺盛な需要を着実に取り込み、受注面において力強い成長を実現できたものと考えております。

一方で、EV 関連における一過性費用等の計上により前期比で減益となり、収益性の向上が重要な課題として明確になった一年でもありました。受注の伸長を持続的な利益成長へと確実につなげていくことが、当社の最優先課題であると認識しております。

事業環境に目を向けますと、AI データセンター向けの需要が一層拡大を続けております。その一方で、部材調達リードタイムの長期化などによる装置リードタイムの長期化が懸念事項として顕在化しつつあり、供給体制の強化や生産効率向上の施策を通じて、これらの課題に着実に対応してまいります。

2. 過去最高となった受注高について、増加した主な内容を教えてください。

A: 主な品目別の受注状況は以下のとおりです。

・半導体電子（前期比+429 億円）

・ロジック分野におきましては、下期に中国向けメタルハードマスク（MHM）の受注が大幅に増加したことに加え、先端向けも堅調に推移したことにより、大幅な増加となりました。

・メモリ分野におきましては、HBM（広帯域メモリ）の需要拡大を背景に、DRAM 大手 3 社による投資が拡大いたしました。とりわけ 26/6 期におきましては、北米メーカーによる投資が大きく寄与いたしました。こうした旺盛な半導体投資需要を着実に取り込み、受注の伸長につなげることができたものと考えております。

・パッケージング分野におきましては、WLP（ウエハーレベルパッケージング）向けアッシング装置の好調が持続いたしました。これに加え、PLP（パネルレベルパッケージング）に係る量産開発投資が本格的に始動したことにより、受注は大幅な増加となりました。

・ディスプレイ・エネルギー（前期比+205 億円）

LCD 向けにおいて改造案件や設備の増強投資が行われました。また、OLED 向けにおきましては、大手を中心とした第 8 世代への投資が集中するなど、好調な中国市場の需要を着実に取り込み大きく増加しました。

・一般産業（前期比+290 億円）

レアアース関連の受注拡大、リークテスト装置も好調だった（当期よりコンポーネントからの品目移管）ことに加え、CS 分野の増加も寄与しました。

3. 一過性要因の詳細および今後も発生するのか等リスクの有無も教えてください。

A: 一過性費用 58 億円については、四半期それぞれ、3Q に約 23 億円を主に EV 関連費用等の貸倒引当金として販管費に計上し、4Q に約 35 億円を追加コスト計上等で売上原価に織り込みました。

＜一過性要因＞

- ①売上期ズレ（半導体）14 億円：顧客要因により、大口の検収基準案件が 4Q から来期計上となった
- ②EV 関連費用 37 億円：貸倒引当金や追加コストの計上等によるもの
- ③品質検証補完対応 7 億円：マテリアル事業の検査装置不具合によるリカバリー費用

なお、これら一過性要因については 27/6 期に影響なく、現時点において、その他の大きなリスク（減損等）は認識しておりません。

【27/6 期の見通し】

4. 27/6 期の業績予想（ガイダンス）の考え方について教えてください。

A: 業績予想の前提につきまして、第一に、事業改革の実施に伴う剥落分を織り込んでおります。具体的には、受注高で約 286 億円、売上高で約 200 億円、営業利益で約 15 億円程度の減少を見込んでおります。第二に、期初において 1,761 億円という高水準の受注残高を有してスタートするものの、部材調達リードタイムの長期化を受けて売上・利益計上に遅れが生じることを反映し、全体的に保守的な業績予想となっております。これらの課題を早期に解決することで、売上・利益の着実な積み上げを図ってまいります。

5. 部材供給の制約によるリードタイム長期化について、従来のリードタイムとの差も教えてください。

A: 半導体製造装置につきましては、前期に発生したフォーキャストに無い受注集中による事前の部材手当困難や旺盛な需要による部材調達の長期化を背景に、従来の 6 ヶ月程度から 2～3 ヶ月程度リードタイムが長期化しております。一方、ディスプレイ製造装置のリードタイムは約 1 年と従来から大きな変化はございません。レアアース関連につきましては、当期からの新たな生産体制構築への移行期間であることも重なり、現在 1 年を超える見込みとなっております。

6. どのような部材の調達リードタイムが長くなっているのでしょうか。またどのような対策を打っていくのでしょうか。

A: 現在、半導体製造装置向けの電子モジュール全般、およびポンプ等コンポーネント向けのレアアース磁石において、調達リードタイムの長期化が発生しております。これに対し、状況に応じた集中的な対策を講じており、電子モジュールでは共通購買を通じたサプライヤー連携の強化等、レアアース磁石では代替品の積極採用等を進めることで、概ね半年から 1 年以内でのリードタイム正常化を図ってまいります。

【投資動向】

7. 半導体（ロジック・メモリ）の投資動向と今後の見通しについて教えてください。

A: ・ロジック

ロジック向け投資につきましては、全体として高水準が継続する見通しです。前期に見られた中国市場における集中投資の反動を考慮し、現時点での当期の中国向け受注は前期並みと保守的に見込んでおります。しかしながら、同市場でのロジック投資自体は継続すると見ており、今後の動向次第では追加受注の可能性もございます。

また、先端プロセス向けにおきましては、台湾ファウンドリ等の投資が引き続き堅調に推移しているほか、北米ファウンドリ向けの案件も計画に一部織り込んでおります。

・メモリ（DRAM・NAND）

メモリ向けにつきましては、当期も強い HBM（広帯域メモリ）需要を強力な追い風として、引き続き大手 3 社の投資意欲の高い DRAM 分野が全体の成長を牽引いたします。

DRAM におきましては、当社がこれまで獲得してきた金属膜工程における POR（Process of Record：顧客の標準製造工程）の実績を起点とし、デバイスの世代交代局面においても継続して当社の装置が採用されております。これに加え、顧客の新工場立ち上げ時にも展開・採用が進んでおり、これが力強い受注の増加に繋がっております。

また、NAND 向けにつきましても、日系メーカーを中心とした堅調な設備投資が継続すると見ております。

8. パッケージングの投資動向は？

A: GPU 需要の拡大に伴うパッケージングの増産を背景に、WLP（ウェハレベルパッケージ）向けアッシング装置の受注は前期に引き続き好調に推移する見込みです。当社の強みである微細プラズマ技術が高く評価され、WLP のデスカム工程においては当社の装置がデファクトスタンダード化しつつあり、顧客の生産能力増強に伴う継続的な投資が見込まれます。

また、WLP 向けに加え、台湾 OSAT や国内メーカーによる PLP（パネルレベルパッケージ）の量産開発投資による継続的な寄与も見込んでおります。今後の市場拡大が期待される PLP 関連ビジネスにつきましても、先行して案件獲得を進め、更なる成長を目指していきます。

9. パワーデバイス・オプトデバイス・電子デバイスの投資動向は？

A: ・パワーデバイス

AI・データセンター向けの需要は好調に推移しておりますが、EV 向けと比較してウェハ 1 枚あたりのチップの取り数が約 4 倍多く、顧客が既存の生産キャパシティで十分に対応できる状況にあります。そのため、現状では大規模な設備投資の動きには繋がっておりません。こうした環境のもと、当社といたしましては、窒化ガリウム（GaN）など次世代パワーデバイス向けの新素材分野の市場開拓を強化し、先々の需要拡大に向けた準備を着実に進めてまいります。

・オプトデバイス

前期は中国市場において AR/VR 向けの大口投資案件がございましたが、一巡したため、当期の新規投資案件は落ち着いた推移になることを見込んでおります。受注活動におきましては収益性を重視し、当社の技術的優位性が活かせるスパッタリング装置などの高付加価値な案件に限定して獲得していく方針です。

・電子デバイス

AI・データセンター市場の拡大が強力な追い風となり、前期に引き続き通信デバイス向けの投資が堅調に推移しております。当期につきましても好調な事業環境が継続すると見ておりますが、業績計画の策定におきましては、現時点で確実に見込める案件のみをベースとした保守的な受注予想としております。

10. ディスプレイ・エネルギーの投資動向は？

A: ・ディスプレイ

前期は、中国メーカーによる第 8 世代（G8）サイズ OLED 向けの新規ライン投資や、LCD の設備追加投資案件などにより、受注が好調に推移いたしました。当期につきましては、LCD の新規ライン投資を一部見込んでいるものの、OLED 向けは追加設備および改造案件が中心となり新規ライン投資を見込んでいないため、前期からの反動減を予想しております。

なお、収益性に関しましては、構造的に半導体・電子デバイス関連と比較して低いものの、過去の案件と比較して採算の改善が進んでおります。

今後のディスプレイ事業に関する方針に変更はございません。成長領域である半導体・電子デバイス分野へ経営リソースをシフトしつつ、ディスプレイ関連の生産については中国拠点へ移管・集中させることで、生産効率の最適化と利益率のさらなる改善を図ってまいります。

・エネルギー（バッテリー・巻取装置関連等）

巻取装置関連につきましては、AI・データセンター向けのキャパシタ需要の寄与などもあり、引き続き堅調に推移しております。

一方、バッテリー関連におきましては、足元で大規模な設備投資の動きは見られず、前期の受注実績は限定的となりました。当期につきましても、開発機案件として 10 億円弱の受注を見込むに留まっております。こうした状況下におきまして、当社といたしましては、今後の市場成長を見据え、次世代技術である「リチウムの両面蒸着技術」の開発にリソースをシフトし、需要の立ち上がりに向けた準備を進めてまいります。

11. レアース磁石関連ビジネス（一般産業）の投資動向は？

A: 前期は米国を中心とした受注が増加するなど、顧客におけるサプライチェーンの多角化に伴う生産拡大の動きが本格化いたしました。当期におきましても、同様の力強い受注トレンドが継続すると見ておりますが、業績計画上の受注予想につきましては、現時点で確実に見込める案件をベースとした保守的な見通しとしております。

一方で、足元の引き合いベースではすでに 200 億円以上のポテンシャルが存在しております。これらの旺盛な引き合いを確実な受注へと結びつけ、計画からのさらなる上積みを狙ってまいります。

なお、当該領域の製造装置は当社の既存技術をベースとした高収益な製品であり、今後のビジネス拡大が利益率の向上に対しても貢献していく見込みです。

バリューアッププラン（事業改革・生産改革）等

12. 「事業改革」について、進捗状況やどの程度の効果が表れているのか等、今後の施策とあわせて教えてください。

A: 事業改革につきましては、当初想定していたプランに沿って実行しており、概ね計画通りに進捗しております。具体的な成果および今後の施策は以下の通りです。

・事業売却・縮小

事業の売却・縮小の取り組みについて、前期はディスプレイ関連のマテリアル事業（中国拠点）の譲渡を完了いたしました。本件に伴う売上および利益の一時的な減少はございますが、低利益率ビジネスの切り離しとなるため、全社的な利益率の向上に確実に寄与しております。今後につきましても、当初定めた事業改革を完遂させるとともに、事業ポートフォリオのさらなる最適化を図るべく、追加での事業売却や縮小の必要性について改めて総点検を実施してまいります。

・生産拠点再構築

生産拠点再構築に伴う人員適正化につきましては、当初の計画に沿って施策を実施しており、これに伴い当期は約 20 億円の固定費削減効果を見込んでおります。この見直しによって生み出された資金は、今後の更なる成長に向けた研究開発投資等へと充当しております。

今後の生産拠点再構築につきましては、足元の事業環境等を踏まえ、既存の工場や設備の有効活用を含めた全体的な再点検を進めていく方針です。

13. バリューアッププラン総点検・変革とあるが、最も重要なテーマとされている「生産改革」について今後の進め方を教えてください。

A: 部材供給や生産面の制約により、獲得した豊富な受注を十分に売上・利益へ転換できていないことが、現在の当社の大きな課題であると認識しております。この課題に対して、従来の延長線上の改善だけでは不十分であり、生産体制全体を抜本的に見直し、売上および利益の最大化を最優先で進めてまいります。

従来から進めている「モジュラーデザインの推進」は継続して取り組む一方、旺盛な受注を確実な収益へ転換させるため、当期は「調達・物流・生産」の各機能の最適化へ集中的に取り組めます。

・調達面の改革

前述の通り、サプライヤー戦略を見直し、共通購買の推進や代替品の積極採用等により、部材調達リードタイムの短縮を強力に進めます。

・物流面の改革

各拠点にある物流スペースの集約・見直しを行い、外部倉庫の活用や自動化を推進することで物流効率を高めまします。さらに、これによって空いた物流スペースを生産スペースへと転換し、生産キャパシティの向上に繋がります。

・生産面の改革

現在の生産キャパシティは足元の需要に対応できる体制にありますが、31/6 期の売上目標である 3,600 億円を見据えた場合、十分とは言えません。そのため、半導体・電子デバイスの主要製造拠点である九州工場の増強投資を検討するとともに、レアアース関連については茅ヶ崎工場での生産開始を進めます。

これらの生産拠点再構築の取り組みを包括的に再点検し、全体の生産体制を最適化することで、生産キャパシティの向上と製造リードタイムの短縮を図ります。当期（27/6 期）中に、これらの体制整備を完遂させ、来期（28/6 期）以降の確実な売上・利益の向上へと繋げてまいります。

14. 外部環境として、関税や地政学リスクの影響はありますか？

A: 基本的に関税については、買い手負担を適用しているため、関税による直接影響は限定的です。エンド需要減速による間接影響を引き続き注視していきます。また、現時点で顧客からの受注に目立った変化ありません。中東情勢による直接的な影響はございません。一方、中国からのレアアース等の円滑な調達は不透明感が高まっています。

以上